

関西

# Workshop2010

## 今がチャンス！ 勝利へ導く実装技術

開催日： 2010年7月9日(金)  
会場： コープ・イン・京都  
参加費： 正会員・賛助会員 協賛団体会員 19,000円  
学生会員 1,000円  
一般 29,000円、学生一般 3,000円  
(資料代、消費税を含む)  
定員 100名 (定員になり次第受付を終了します。)

エレクトロニクス実装学会主催、関西ワークショップは、ポスターセッション形式のディスカッションを通じ、新技術を知ることだけでなく、知りたいこと、わからないことを質問できる場として毎年好評を博しております。

エレクトロニクス機器製造プロセスにおいて後工程に当たる実装の拠点を経費の安い海外へと移行する傾向にあります。高度な技術が必要なもの、高い信頼性が要求されるものが日本で次々と生み出され、勝ち負けのはっきりした構図になっているのが現在の実装業界だと考えられます。当学会はそうした実装技術創出のきっかけとなる種まきを行うことで、持ち帰った皆様が更にそれをブラッシュアップすることで成果を刈り取り、勝利へと導くことができると確信しております。自由なディスカッションの場ですので、写真撮影、録画・録音は一切禁止です。ディスカッションこそが本当に知りたい、役に立つ技術へ到達する近道です。多数のご来場をお待ち申し上げます。

今年の招待講演にはLED、太陽電池ビジネス動向とその将来について産業タイムス社社長の泉谷渉様に最新の情報をご提供いただきます。

ポスターセッションは、3D実装(スタッキング、部品内蔵基板) 高耐熱接合技術(ナノ粒子、はんだ) MEMS、信頼性(解析、評価、予測)に関する最新の技術を紹介致します。

最後になりましたが、カジュアルな服装でのご参加を推奨しております。

### 申込方法

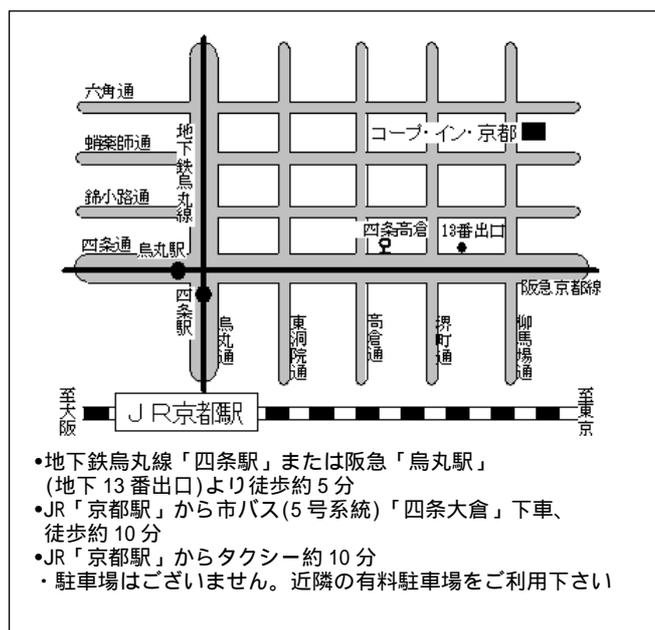
裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、エレクトロニクス実装学会事務局までファクシミリまたは郵便でお送りください。

お支払いは、お申込み受付後、参加券と請求書をお送りしますので、銀行振込をお願いします。

事務局：(社)エレクトロニクス実装学会  
〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2  
TEL:03-5310-2010 FAX:03-5310-2011

<http://www.e-jisso.jp>

協賛：日本材料学会関西支部、日本金属学会関西支部、溶接学会、日本機械学会関西支部、日本接着学会、日本信頼性学会関西支部、表面技術協会(交渉中を含みます)



関西ワークショップ 2010 「今がチャンス！ 勝利へ導く実装技術」

10:00 ~ 10:10	開会、オリエンテーション
10:10 ~ 11:10	アブストラクトトーク (各発表者 3分)
11:15 ~ 12:45	<b>特別講演「環境エネルギー革命は半導体の世界を変える」</b> <b>泉谷 渉 氏 / 産業タイムズ社 社長</b>
12:45 ~ 13:45	休憩
13:45 ~ 16:50	ポスターセッション
17:00	閉会

テーマ (仮題を含む)	発表者 (敬称略)
1. パワー半導体用鉛フリー高温はんだ接合技術	(株)豊田中央研究所 山田 靖
2. 薄型 WLP 内蔵ポリイミド多層配線板	(株)フジクラ 佐野 宣紀
3. 3次元ハイブリッドパッケージングのための TLP ボンディング技術	新光電気工業(株) 村山 啓
4. 40 μm pitch マイクロボール搭載用メタルマスク及び狭ピッチ印刷用メタルマスクについて	アテネ(株) 田丸 敦己
5. バッチ式 Die-to-Wafer 三次元集積化技術	東北大学 福島 誉史
6. LED向けサファイア薄化研削への新プロセス提案	(株)ディスコ 長澤 唯人
7. 導電性接着剤の概要(熱・電気等を中心として)	住友金属鉱山(株) 小日向 茂
8. ジョイントプロテクトフラックス ペースト	千住金属工業(株) 北沢 和哉
9. WLP 用液状成形樹脂	長瀬産業(株) 西川 雄基
10. 三次元集積デバイスの開発動向	日本アイ・ビー・エム(株) 折井 靖光
11. カメラモジュールのリフロー実装技術と耐熱レンズの特性確保	(株)東芝 セミコンダクター社 中條 博則
12. SOI 技術と貼り合わせによる素子積層技術 - 裏面照射型 CMOS イメージセンサーへの応用例 -	Soitec Asia(株) 吉見 信
13. 赤外線センサの真空パッケージング技術	立命館大学 久田 啓介、松村 剛至、土永 明延、木股 雅章
14. MEMS 気密封止パッケージ	京都大学 菅野 公二
15. 銅ナノ粒子の開発と導電性ペーストへの応用	大阪市工業研究所 山本 真理
16. 各種ストレス環境下で発生するイオンマイグレーション現象とその解析結果	エスペック(株) 田中 浩和
17. 温度負荷によるはんだ接合部の組織変化と強度低下が振動負荷寿命に及ぼす影響	大阪大学 松浪 弘貴
18. パッケージ内応力に起因した半導体デバイスの電気特性変動評価 : 電子散乱確率変化を考慮したデバイスシミュレーション	京都大学 吉田 圭佑
19. デジタル画像相関法によるひずみ計測を利用した次世代三次元積層チップの熱応力解析精度の改善	京都大学 河原 真哉

プログラムは一部変更される場合があります。最新情報は学会のホームページ (www.e-jisso.jp) に掲載します。

関西ワークショップ 2010 参加申込書 [開催:2010年7月9日]

ふりがな \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_

勤務先 \_\_\_\_\_

所属(役職) \_\_\_\_\_

所在地(〒 \_\_\_\_\_)

会員区分:	正会員 (会員番号 _____)
(レ印)	賛助会員 (会員番号 _____)
	賛助会員 (会員番号 _____)
	協賛団体会員
	団体名 _____
	(会員番号 _____)
	一般
	学生一般

TEL \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_